

通号（北京）轨道工业集团有限公司

集成电路可编程逻辑处理器采购项目

竞争性谈判编号: **BJGY-201807-JT01**

通号（北京）轨道工业集团有限公司集成电路可编程逻辑处理器采购项目竞争性谈判，现邀请符合本项目资格条件的供应商参加谈判。

1. 竞争性谈判内容

1.1 项目名称：通号（北京）轨道工业集团有限公司集成电路可编程逻辑处理器采购项目

1.2 竞争性谈判编号：BJGY-201807-JT01

1.3 项目概况及内容

竞争性谈判范围：见附件

2. 供应商资格要求

2.1 主体要求：在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区），依法注册具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的供应商。

2.2 资质要求：应具备工商行政管理部门核发三证合一的营业执照。

2.3 财务能力：公司运行正常且有良好的财务状况。

2.4 符合法律、法规规定的其他条件。

2.5 本项目不接受联合体竞争性谈判。

3. 竞争性谈判文件的获取

3.1 凡收到竞争性谈判邀请的供应商，请于 2018 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 18 日，每日上午 9 时 00 分至 11 时 30 分，下午 13 时 00 分至 16 时 30 分（北京时间，节假日法定休息日除外），至竞争性谈判文件购买地点：北京市大兴区黄村镇狼垡四村 456 号：通号（北京）轨道工业集团有限公司 9 号楼 219 室获取竞争性谈判文件。

3.2 竞争性谈判文件每份售价 200 元，售后不退。

3.3 供应商在购买竞争性谈判文件时必须出示如下有效期内的资质证书原件，包括：

(1) 三证合一的营业执照

(2) 竞争性谈判代表人身份证及法人委托授权书

4. 竞争性谈判响应文件的递交

4.1 竞争性谈判响应文件递交的时间为：2018 年 6 月 28 日 8 时 30 分至 9 时 30 分，递交竞争性谈判响应文件的截止时间（竞争性谈判截止时间，下同）为 2018 年 6 月 28 日 9：30 时。

4.2 竞争性谈判响应文件递交地点及谈判地点为：中国通号产业园 A 座 1532 会议室，地址：北京市丰台区汽车博物馆南路中国通号产业园，竞争性谈判响应文件需当面递交给采购人。逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

5. 联系信息

采购人名称：通号（北京）轨道工业集团有限公司

地址：北京市大兴区黄村镇狼垡四村 456 号

联系人：王瑾

邮政编码：102613

联系电话：010-51214086

电子邮箱：2024688308@qq.com

附件:

单位: 含税、元

序号	品号	产品名称	数量	单位	品牌
1	2000001530	集成电路可编程逻辑器件 \EPM9320LI84-20\ALTERA\贴装	1980	个	ALTERA

二、技术要求

1、引用和参考的相关标准

- GB4589-89 半导体集成电路总规范
- GB7092-96 半导体集成电路外形尺寸
- GJB1649-93 电子产品防静电放电控制大纲
- GB191 包装储运图示标志
- EIA-481-A 表面安装器件卷带盘式包装
- IPC/JEDEC J-STD-033B 潮湿/回流敏感 SMD 的处理、包装、装运和使用
- IPC/ECA J-STD-002C 元器件引线、端子、焊片、接线柱和导线的可焊性测试
- GJB 4027A-2006 军用电子元器件破坏性物理分析方法
- GJB 548B-2005 微电子器件试验方法和程序

2、一般要求

*器件外观必须平滑、洁净、无油污、无伤痕和裂纹；器件引脚无变形，表面无氧化；BGA 封装器件焊球尺寸、焊球间距误差不得超过标准；焊球表面气泡面积不得超过焊球表面积的 20%；焊球内部不得有气泡。器件正面应有如下标志或信息，且必须清晰和耐久：

*A. 型号标识 (Marking)：由字母和数字组成，型号标识应易于识别；当型号标识与厂家资料中给出的器件完整型号不一致时，厂家有义务给出合理解释，并及时正式通知；

*B. 制造商的名称、代号或标志;

*C. 明显的首引线识别标志; BGA 器件的底面颜色同焊球颜色要有明显视觉色差;

*D. 外包装上应标明生产批次、封装产地、版本质量等级等信息; 同时, 在条件允许情况下, 器件上应标明生产批次、封装产地、版本、质量等级等信息。

3、技术要求

(1) 包装方式:

**对芯片外包装密封性、完整性和标签的相关要求:

对于批量采购的芯片, 供方提供产品的包装必须是防静电袋包装, 必须贴有防静电标识或字样, 包装上应有如制造商、型号、封装、是否含铅、生产日期等信息。

对于不满足最小包装数量的小批采购芯片或样品, 供方同样需要采用安全可靠的方式进行密封包装, 所用包装必须满足防静电、防潮要求, 以保证芯片不致静电击穿、受损、受潮, 且包装上必须有关于产品规格型号、数量、品牌、厂家等的信息标签, 严禁采用随意包



装的方式直接邮递过来, 如图 1、图 2 所示:

图 1 小批量芯片包装合格示例

图 2 小批量芯片包装不合格示例

(2) 对湿敏器件的相关要求:

****密封性:** 要求来料芯片必须抽真空原厂密封包装。

****干燥剂和湿敏指示卡:** 要求来料包装里必须具备干燥剂和湿敏指示卡。

****要求来料外包装塑料袋上贴有正规湿敏标签, 标注湿敏等级、烘烤方法、车间寿命等关键信息, 如图 3 所示。**

Caution
This bag contains
MOISTURE-SENSITIVE DEVICES
注意
袋内装有湿敏器件

1. Calculated shelf life in sealed bag: 12 months at $\leq 40^{\circ}\text{C}$ and $\leq 90\%$ relative humidity (RH)
2. Peak package body temperature: _____ $^{\circ}\text{C}$
 密封体峰值温度: _____
 If blank, see adjacent bar code label
3. After bag is opened, devices that will be subjected to reflow solder or other high temperature process must be
 a) Mounted within: _____ hours of factory conditions
 $\leq 30^{\circ}\text{C}/80\%$ RH, or 以下时间内完成组装, _____ 小时车间寿命
 If blank, see adjacent bar code label
 b) Stored per J-STD-033
4. Devices require bake, before mounting, if:
 a) Humidity Indicator Card reads $>10\%$ for level 2a - 5a devices or $>60\%$ for level 2 devices when read at $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$
 b) 3a or 3b are not met
5. If baking is required, refer to IPC/JEDEC J-STD-033 for bake procedure
Bag Seal Date: _____
包装日期
If blank, see adjacent bar code label
Note: Level and body temperature defined by IPC/JEDEC J-STD-020

图 3 湿敏标签及需要标注的信息

注: *为偏离项, **为 KO 项。

通号(北京)轨道交通工业集团有限公司

2018年6月13日

